

2010年3月期 第2四半期決算補足資料 (2009年11月)



2010年3月期第2四半期決算 会社説明会

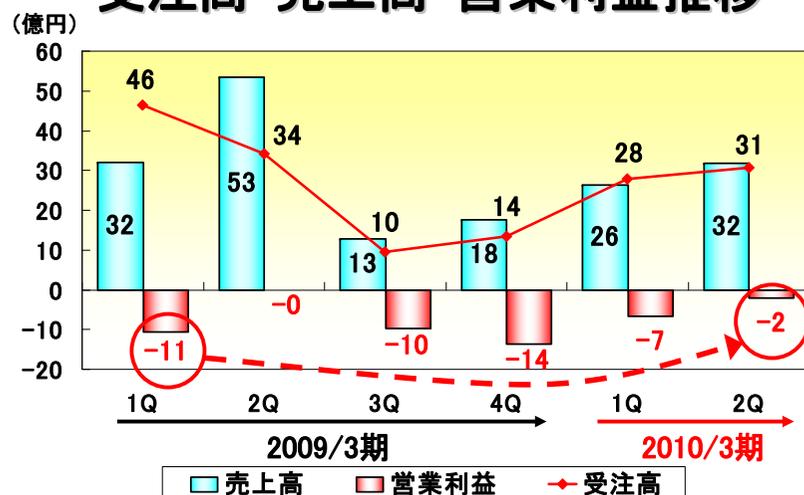
2009年11月
TOWA株式会社

2010年3月期上半期業績概要

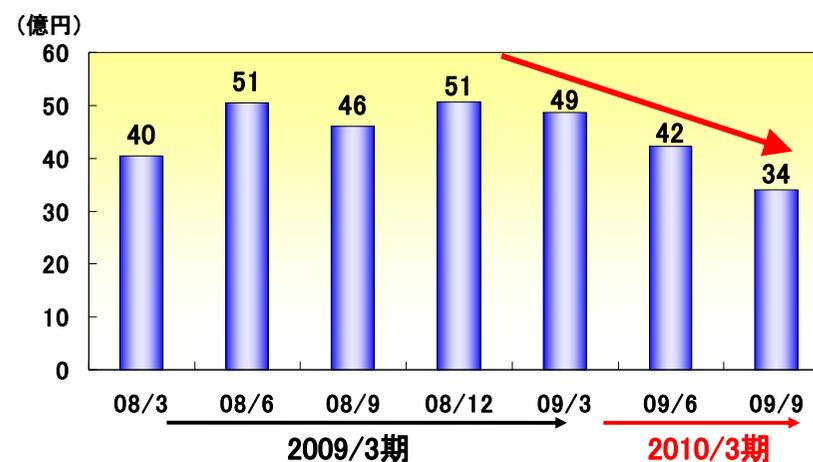
(百万円)

	前期実績	上期実績	前期比
売上高	8,527	5,831	△2,696
売上総利益	1,358	756	△602
《同率》	《15.9%》	《13.0%》	《△2.9ポイント》
営業利益	△1,051	△867	+184
経常利益	△1,116	△1,037	+79
当期純利益	△1,238	△979	+259

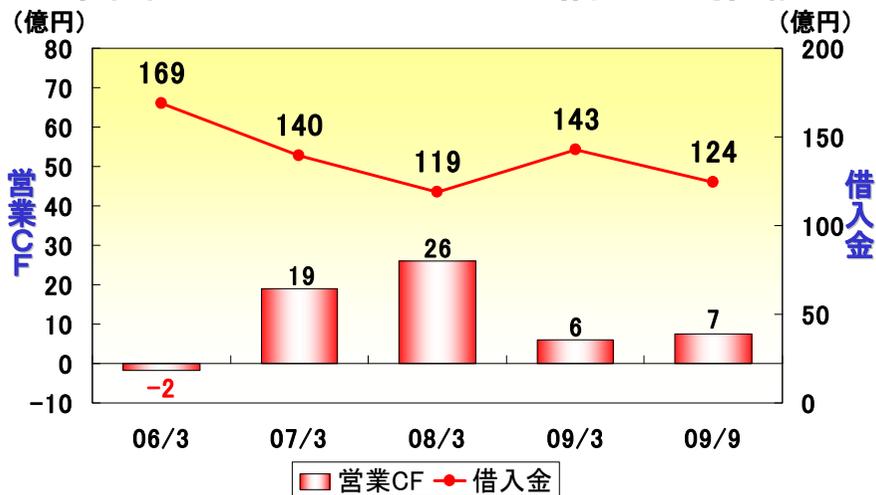
受注高・売上高・営業利益推移



たな卸在庫推移



営業キャッシュフロー・借入金推移



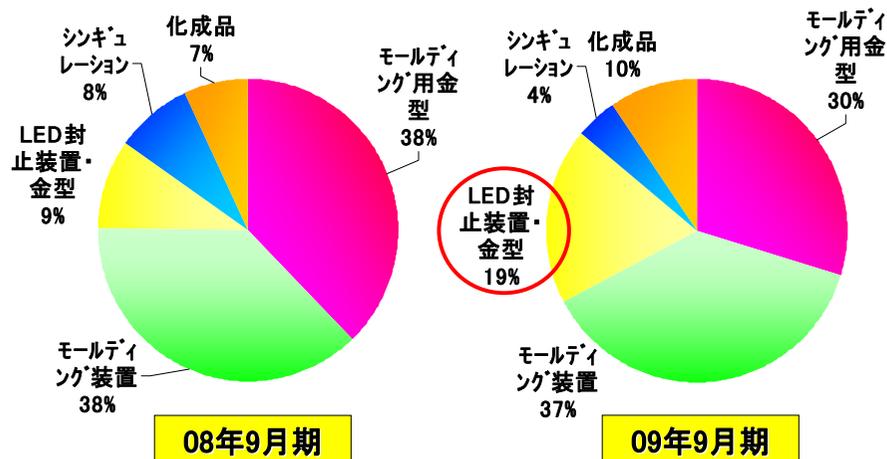
中期経営計画 進捗状況

受注環境にあわせた「固定費コントロール」と「原価低減」で収益体質を改善

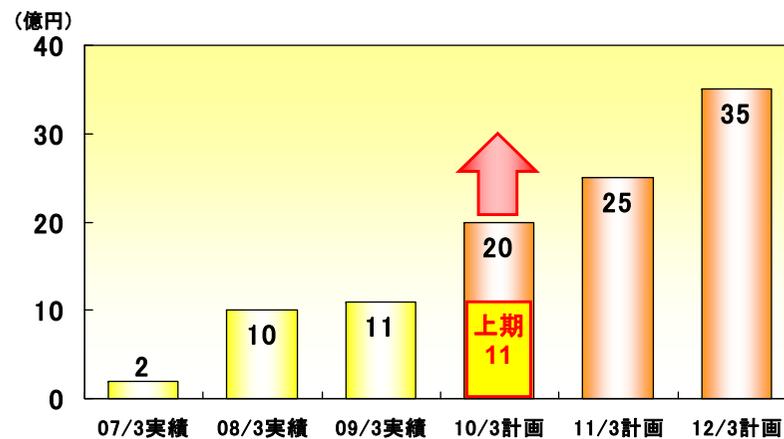
(上半期の結果)

- ・固定費を前年同期比13億円削減
- ・中国地域での低採算
- ・たな卸在庫の圧縮
- ・円高に伴う価格圧力

事業ポートフォリオの見直し 製品別売上高構成



LED樹脂封止装置・金型売上高推移



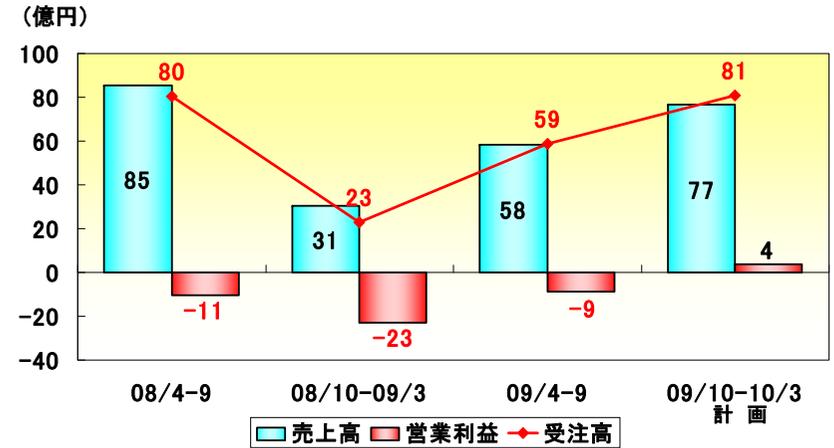
2010年3月期通期業績計画

(百万円)

	前期実績	今回公表	前期比	5/14公表
売上高	11,577	13,500	+1,923	11,500
営業利益	△3,337	△500	+2,837	100
経常利益	△3,677	△700	+2,977	100
当期純利益	△4,163	△700	+3,463	100

9

受注高・売上高・営業利益推移(連結)



10

下期業績見通し

- 台湾を中心に設備投資は回復基調
- 操業短縮を打ち切り
- 新製品 (PMC、LCM) の引き合い増加
- 売上が伸張する中国は、リードフレームタイプが中心のため、価格競争が厳しい
- 円高基調

11

— 3 —

2010年3月期 下期重点戦略

- 回復基調の台湾での拡販
- コンプレッションモールド装置の拡販
- LED樹脂封止装置の拡販
- 自動車部品関連市場の開拓
- ➡ 操業短縮を打ち切り

12

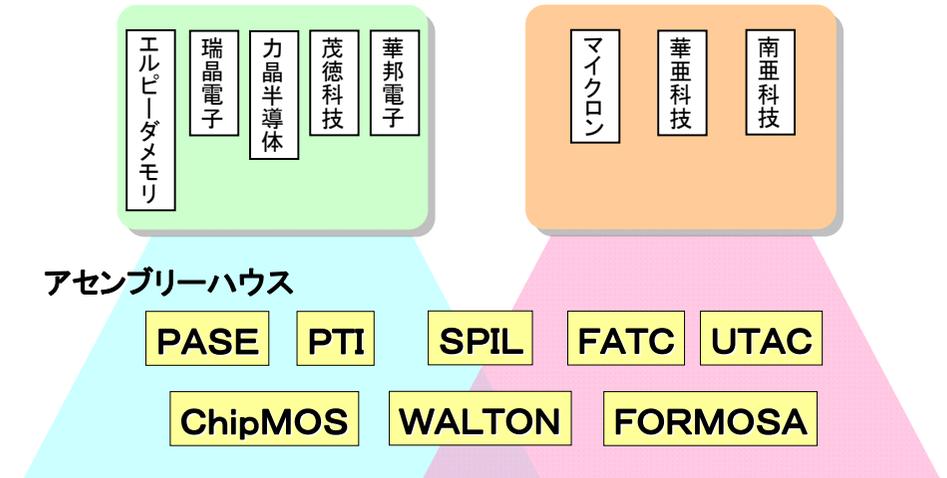
台湾市場の動向

- 設備投資に対する減税措置(7%)
年末までに注文書の発行が必要
- 銅ワイヤー化の流れ
アSEMBリーハウスのワイヤーボンダー投資
が活発化
- リードフレーム・基板の幅広化
追加金型、新規装置の受注

13

回復基調の台湾での拡販

DRAM・アSEMBリーハウス



14

LED市場の急速な立ち上がり

0.5円/ルーメンと200ルーメン/Wの両立へ

2011年に上記目標を達成する為、チップからパッケージ全てに対する改善が急速に進んでいる

1. 内部量子効率(電力を光に変換する効率)
2. チップの光取出し効率(LEDチップの外に出る光の割合)
3. 蛍光体変換効率
4. パッケージの光取出し効率

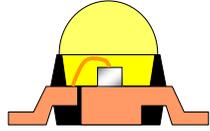
15

パッケージ技術の改良策

1. 光束の増加: パッケージからの光取り出し効率の向上
レンズ形状、小型パッケージ化
2. ドループの抑制: パッケージの放熱性の向上
セラミック基板(L/F基板)、耐熱樹脂(シリコン樹脂)の採用
3. 製造コストの削減: パッケージ部材費の削減や構造の簡素化
プリモールド削除、パッケージ工程の簡素化、
パッケージ小型化による生産性の向上
4. 長寿命化: パッケージの反射率の経時劣化の抑制
プリモールド削除、プリモールド部材の変更

16

圧縮モールド・パッケージの優位点



従来のプリモールド・パッケージ



圧縮モールド・パッケージ

1. プリモールド・パッケージに比べ面積で1/7~8、パッケージ高さも1/3程度に小型化
2. 放熱性が重要な3~5Wのパッケージにも対応
Cuプリモールド・パッケージとセラミックパッケージが同サイズの場合、熱伝導率はCu>セラミックだが、放熱面積を考慮すると熱抵抗はCuプリモールド・パッケージ≧セラミックパッケージ
3. 光の放射角度はプリモールド・パッケージの最大100度と比べ、110度以上が可能
4. 圧縮モールドによる安定した成形品質とパッケージ形状
5. すり鉢状にすることで、光を均等に広く放射させることも可能



ドーム状パッケージ



すり鉢状パッケージ

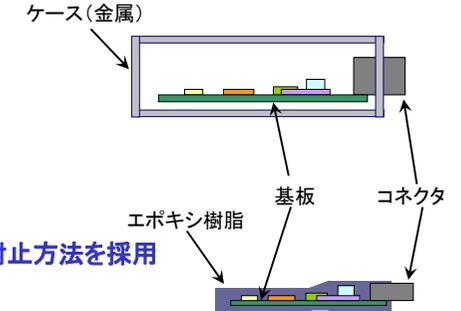
17

新封止分野事業

車載品やパワー系の大型、高電圧のデバイス市場は好調

ECU(エンジンコントロールユニット)に代表される制御装置は「小型化」、
「モジュール化」が進む

(従来)
メタルキャンによるケーシング



(今後)
トランスファーモールドによる樹脂封止方法を採用

- ・信頼性向上
- ・小型、軽量化
- ・コスト低減
- ・生産性向上
- ・異形状パッケージングにも対応

18

車載電子部品用樹脂封止装置「YPS」



装置名「YPS120」

装置の特徴

- ・大型部品のハンドリングに対応
- ・半導体樹脂封止装置を転用
(短期間で開発を完了)
- ・樹脂流動解析による高品質の確保
- ・高スループット
(大型金型による生産個数の確保)



成形サンプルイメージ

19

この資料についてのお問い合わせ

TOWA株式会社 経営企画室

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

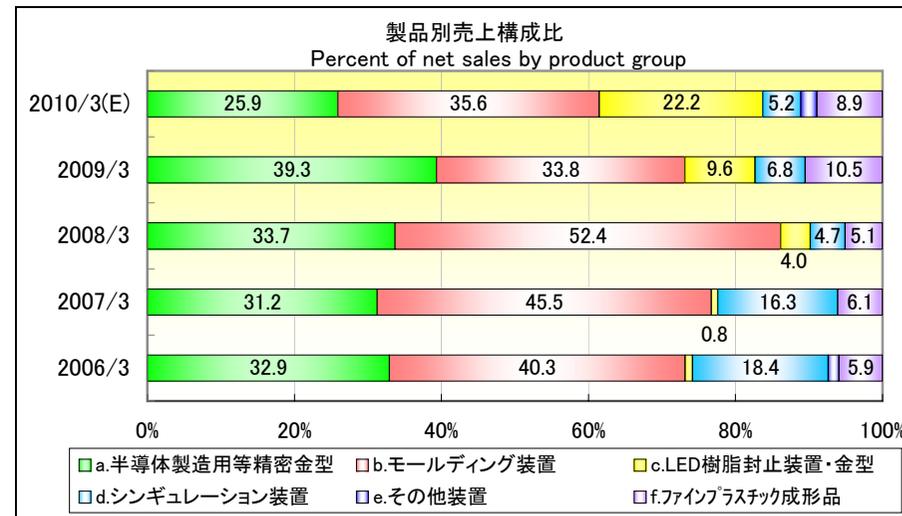
Fax: 075-692-0270

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料における予想は、現在入手可能な情報から得られた情報に基づいており、
潜在的なリスクや不確実性が含まれております。
実際の業績は、様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おください。

20

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



決算期		2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3(E)
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	①Net sales	19,641	25,159	25,753	11,577	13,500
営業利益	Operating income	-3,012	1,224	2,381	-3,337	-500
経常利益	Ordinary income	-2,778	1,289	2,125	-3,677	-700
当期純利益	Net income	-5,923	1,038	2,118	-4,163	-700
総資産	Total assets	36,602	34,925	34,360	27,949	—
純資産	Net assets	13,003	14,941	16,394	11,089	—
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	-275.58	41.59	84.70	-166.45	-27.98
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	-40.8	7.4	13.5	-30.3	-6.5
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	-7.4	3.6	6.1	-11.8	—
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	-15.3	4.9	9.2	-28.8	-3.7
自己資本比率	Equity ratio	35.5	42.8	47.7	39.7	—

(単位:百万円/¥Millions)

	2008/9	2009/9
売上高	8,527	5,831
営業利益	-1,051	-867
経常利益	-1,116	-1,037
当期純利益	-1,238	-979
総資産	32,617	25,122
純資産	14,574	10,200
1株当たり指標		
1株当たり当期純利益	-49.49	-39.15
諸指標		
自己資本当期純利益率	-8.0	-9.5
総資産経常利益率	-3.3	-4.1
売上高営業利益率	-12.3	-14.9
自己資本比率	44.7	40.6

増減率	Percent change	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3(E)
売上高	Net sales	-18.5	28.1	2.4	-55.8	16.6
営業利益	Operating income	—	—	94.5	—	—
経常利益	Ordinary income	—	—	64.8	—	—
当期純利益	Net income	—	—	104.0	—	—

	2008/9	2009/9
売上高	-25.6	-31.6
営業利益	—	—
経常利益	—	—
当期純利益	—	—

※a.Precision molds

b.Semiconductor plastic encapsulation systems

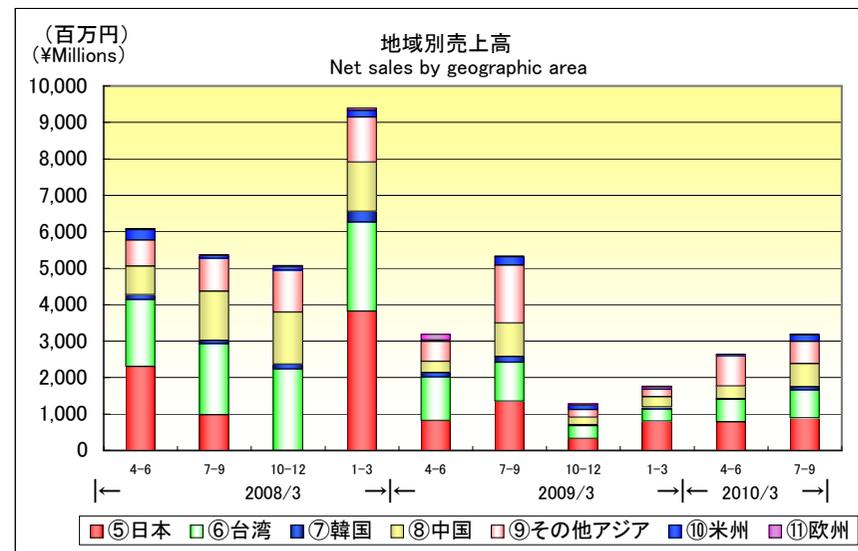
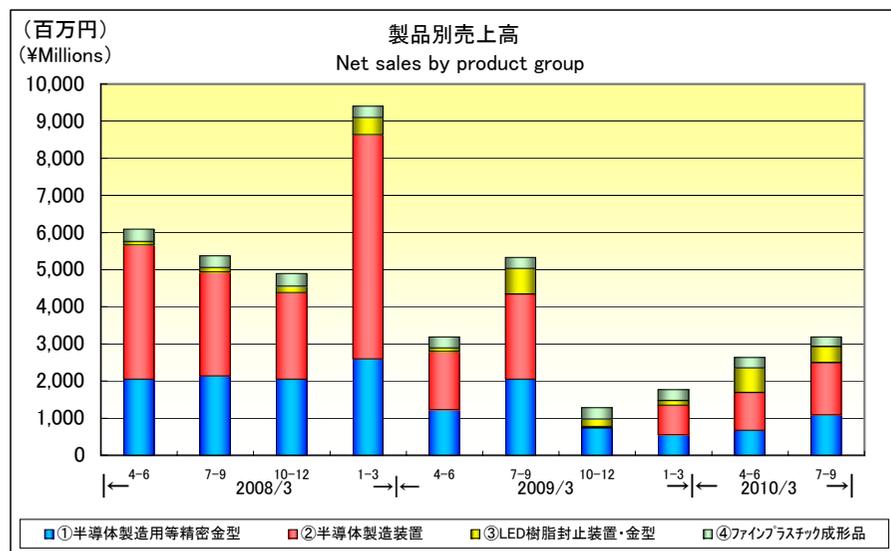
c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED

d.Siguration parts and systems

e.Others

f. Engineering plastic molded products

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



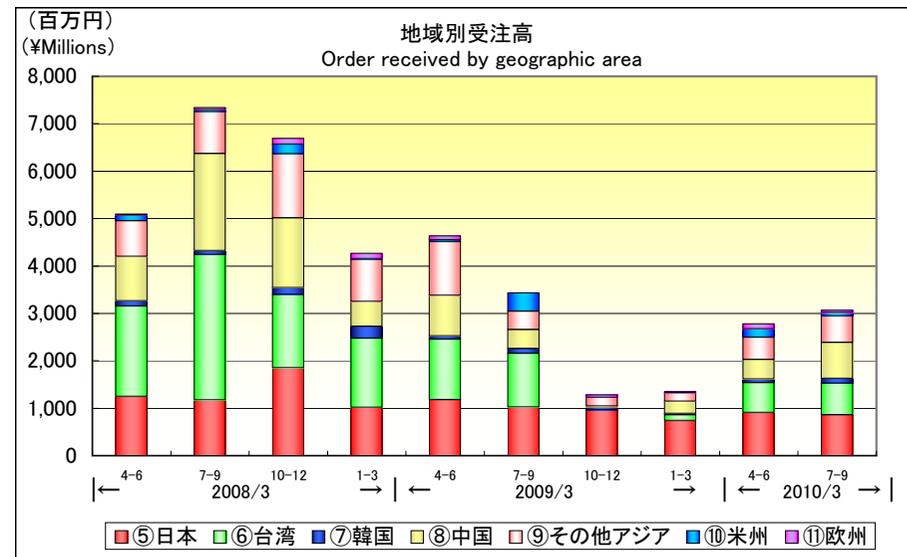
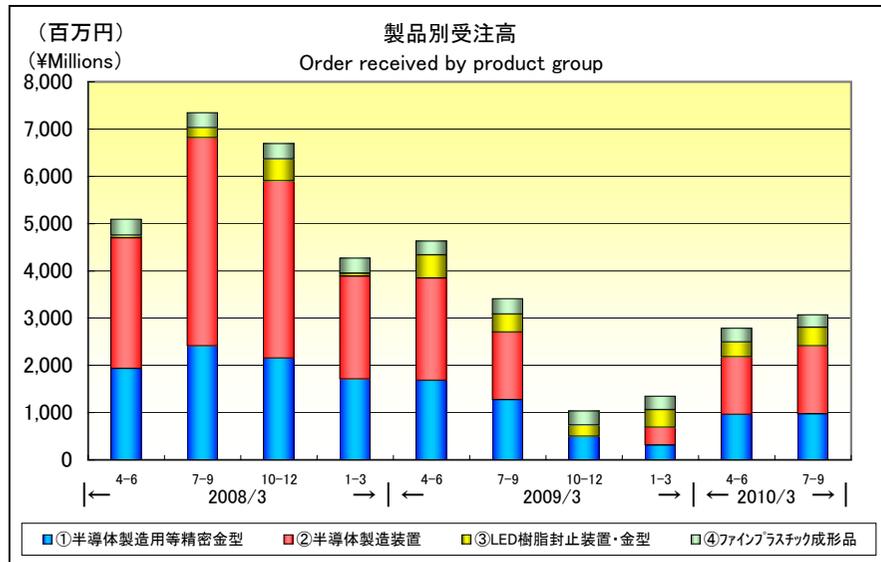
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2008/3					2009/3					2010/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	5,831
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	2,045	2,134	2,049	2,587	8,815	1,218	2,046	739	547	4,552	665	1,086	1,751
半導体製造装置 ②Semiconductor manufacturing equipment	3,615	2,794	2,323	6,045	14,778	1,575	2,299	29	796	4,700	1,021	1,407	2,428
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	93	122	176	454	846	95	681	202	128	1,107	659	435	1,094
ファインプラスチック成形品 ④Engineering plastic molded products	336	319	345	312	1,313	302	307	310	295	1,217	293	261	555
月平均	2,030	1,789	1,631	3,132	2,146	1,064	1,778	428	589	965	880	1,063	972

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2008/3					2009/3					2010/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	5,831
日本 ⑤Japan	2,300	983	-186	3,826	6,924	820	1,347	329	805	3,302	782	892	1,675
アジア太平洋 Asia pacific	3,477	4,283	4,941	5,318	18,020	2,177	3,740	794	876	7,587	1,811	2,100	3,911
(内 台湾) ⑥Taiwan	1,841	1,944	2,237	2,443	8,465	1,195	1,067	355	325	2,943	618	763	1,381
(内 韓国) ⑦Korea	131	89	130	287	639	118	166	18	58	362	22	92	114
(内 中国) ⑧China	781	1,350	1,425	1,351	4,908	309	919	209	287	1,726	341	635	977
(内 その他アジア) ⑨Other asia	722	899	1,148	1,235	4,006	553	1,587	210	204	2,555	829	608	1,437
米州 ⑩America	284	83	97	188	654	31	226	115	36	409	29	182	211
欧州 ⑪Europe	28	19	41	65	154	163	21	44	49	277	17	14	31

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



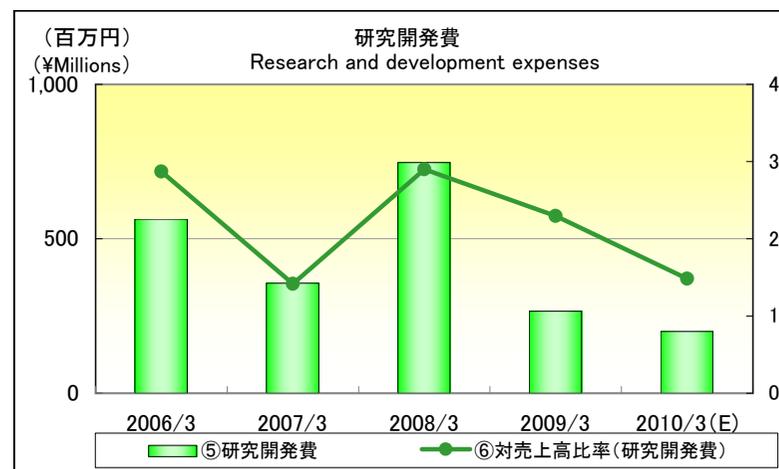
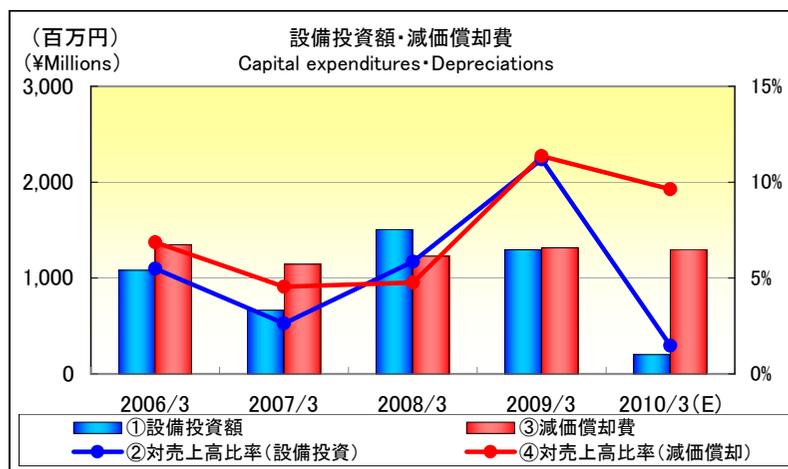
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2008/3					2009/3					2010/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,856
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	1,937	2,411	2,149	1,708	8,207	1,679	1,275	498	314	3,767	961	976	1,937
半導体製造装置 ② Semiconductor manufacturing equipment	2,760	4,404	3,753	2,178	13,096	2,166	1,431	-82	376	3,892	1,217	1,433	2,650
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	57	210	466	62	797	492	376	234	372	1,477	311	395	707
ファインプラスチック成形品 ④ Engineering plastic molded products	342	318	328	318	1,308	296	326	301	288	1,212	295	264	560
月平均	1,699	2,448	2,232	1,422	1,951	1,545	1,137	317	450	863	929	1,023	976

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2008/3					2009/3					2010/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,856
日本 ⑤ Japan	1,249	1,176	1,854	1,015	5,295	1,178	1,024	966	742	3,911	910	863	1,774
アジア太平洋 Asia pacific	3,706	6,078	4,515	3,125	17,425	3,339	2,026	-47	578	5,897	1,590	2,083	3,673
(内 台湾) ⑥ Taiwan	1,909	3,063	1,548	1,459	7,981	1,277	1,135	-307	118	2,223	627	667	1,295
(内 韓国) ⑦ Korea	108	81	143	253	586	70	100	61	32	266	75	97	172
(内 中国) ⑧ China	935	2,054	1,471	525	4,986	854	404	18	254	1,531	415	764	1,180
(内 その他アジア) ⑨ Other asia	753	878	1,351	887	3,871	1,136	386	180	172	1,875	471	554	1,025
米州 ⑩ America	113	41	202	17	375	39	386	-22	7	410	175	74	249
欧州 ⑪ Europe	28	50	124	110	313	78	-27	55	23	130	109	48	158

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結) (Consolidated)		2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3(E)
決算期						
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	-166	1,894	2,587	606	—
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,548	252	-1,083	-1,490	—
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	2,232	-2,203	-1,947	1,972	—
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	3,588	3,542	3,351	4,399	—
設備投資額	①Capital expenditures	1,079	663	1,508	1,296	200
対売上比率	②Ratio of sales	5.49	2.64	5.86	11.19	1.48
減価償却費	③Depreciations	1,349	1,144	1,227	1,315	1,300
対売上比率	④Ratio of sales	6.87	4.55	4.76	11.36	9.63
研究開発費	⑤Research and development expenses	564	356	747	266	200
対売上比率	⑥Ratio of sales	2.88	1.42	2.90	2.30	1.48

(単位: 百万円/¥Millions)		2008/9	2009/9
		-397	738
		-728	-318
		1,351	-1,709
		3,499	3,071
		468	150
		5.49	2.57
		643	639
		7.54	10.96
		177	70
		2.08	1.20